

研磨スラリー

Nanopure™

厳しい技術革新の続くシリコンウェーハの製造に用いられる、一次研磨・仕上げ研磨用のスラリーです。高平坦性、低欠陥、高生産性などの優れた研磨性能を安定して発揮します。

Nanopure™ シリーズ

Nanopure™ シリーズは、シリコンウェーハの一次研磨・二次研磨・仕上げ研磨・エッジ研磨用のスラリーです。

□ 物 性

	NP6504	NP6610	NP7310	NP8020H	NP8065	EG1103S1
砥粒タイプ	コロイダルシリカ	コロイダルシリカ	高純度コロイダルシリカ	高純度コロイダルシリカ	高純度コロイダルシリカ	コロイダルシリカ
砥粒濃度 (wt%)	28.0	40.0	6.0	9.5	7.8	35.0
pH	11.0-13.0	11.0-12.0	10.3-11.3	10.0-11.0	10.0-11.0	11.1-12.1
砥粒サイズ (nm)	60-120	60-110	60-80	60-80	70-120	80-140
研磨工程	1次研磨		2次研磨	セミファイナル	ファイナル	エッジ研磨
特長	高研磨レート	アミンレス高研磨レート	高希釈	高研磨レート	高希釈	エッジ研磨用

- 目的、用途別に応じまして、各種品番をご用意しております。
- 初期ご評価サンプルとして少量の無償サンプルもご用意可能です。



※ Nanopure™はニッタ・デュポン(株)の商標です。

※ 記載されている物性値等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保証するものではありません。